

# RoHS / WEEE

## Richtlinie / Directive 2011/65/EU

Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikmaterial  
Restriction of hazardous substances in electrical and electronic equipment

### Syslogic Datentechnik AG

Täferenstrasse 28  
5405 Baden-Dättwil  
Switzerland

Erklärt in alleiniger Verantwortung, dass folgende Produktserien

- IPC/xxx
- TFT/xxx
- RPC/xxx
- PSU/xxx
- CEM/xxx
- CPN/xxx
- SDB/xxx
- CPC/xxx
- KIT/xxx
- CAB/xxx

In Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie 2011/65/EU (RoHS und WEEE) sind.

Dies gilt auch für Produkte bei welchen begrenzte Mengen der verbotenen Stoffe zugelassen sind, jedoch den Grenzwert nicht übersteigen:

▪ Blei (Pb)	0.1%
▪ Quecksilber (Hg)	0.1%
▪ Sechswertigem Chrom (Cr VI)	0.1%
▪ Polybromiertes Biphenyl (PBB)	0.1%
▪ Polybromierten Diphenylether (PBDE)	0.1%
▪ Cadmium (CrVI)	0.01%

Annex II gemäss 2015/863/EU:

▪ Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0.1%
▪ Benzylbutylphthalat (BBP)	0.1%
▪ Dibutylphthalat (DBP)	0.1%
▪ Diisobutylphthalat (DIBP)	0.1%

Baden-Dättwil

8. März 2022



Raphael Binder  
Product Manager

Declares under sole responsibility that following product series

- IPC/xxx
- TFT/xxx
- RPC/xxx
- PSU/xxx
- CEM/xxx
- CPN/xxx
- SDB/xxx
- CPC/xxx
- KIT/xxx
- CAB/xxx

Are compliant with the requirements of the European directive 2011/65/EU (RoHS and WEEE).

This also includes products where a limited amount of the prohibited substances are permitted, but not exceed the maximum threshold limit:

▪ Lead	0.1%
▪ Mercury	0.1%
▪ Hexavalent chromium	0.1%
▪ Polybrominated biphenyls (PBB)	0.1%
▪ Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	0.1%
▪ Cadmium (CrVI)	0.01%

Annex II according to 2015/863/EU

▪ Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)	0.1%
▪ Benzyl butyl phthalate (BBP)	0.1%
▪ Dibutyl phthalate (DBP)	0.1%
▪ Diisobutyl phthalate (DIBP)	0.1%

Baden-Dättwil

March 8, 2022



Urban Müller  
Head of R&D